```
DialogClassic Web(tm)
T 1/5/1
  1/5/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.
009983025
            **Image available**
WPI Acc No: 1994-250736/199431
XRAM Acc No: C94-114026
XRPX Acc No: N94-198154
 Ink jet recording head mfr. for full line type recording head - by
 forming ink flow path pattern and coating with epoxy resin forming ink
 ejection outlets in coating and dissolving pattern for colour recording
 head
Patent Assignee: CANON KK (CANO )
Inventor: INADA G; MIYAGAWA M; OKUMA N; SATO T; TOSHIMA H; OHKUMA N
Number of Countries: 020 Number of Patents: 010
Patent Family:
                                           Kind
                                                           Week
                            Applicat No
                                                  Date
Patent No
             Kind
                    Date
              A2 19940810 EP 94101556
                                                19940202 199431
EP 609860
              A
                  19941011 JP 9410078
                                            Α
                                                19940131 199445
JP 6286149
                  19951226 US 94190464
                                            A 19940202 199606
US 5478606
              Α
                                            A 19950223
                            US 95392686
EP 609860
              A3 19950816 EP 94101556
                                            Α
                                                19940202
                                                          199613
                                            Α
                                                19940202 199729
                  19950705 CN 94102753
CN 1104585
              A
                                            A 19940202 199826
              B1 19980603 EP 94101556
EP 609860
              E 19980709 DE 94610648
                                            A 19940202 199833
DE 69410648
                            EP 94101556
                                            A
                                                19940202
                           EP 94101556
                                                19940202 199835
              T3 19980716
                                            Α
ES 2116478
                                                19940202 200031
              B1 19981201
KR 152452
                           KR 941857
                                            Α
                  20020313 CN 94102753
                                                19940202 200516
CN 1080645
              C
                                            Α
Priority Applications (No Type Date): JP 9410078 A 19940131; JP 9316238 A
Cited Patents: No-SR.Pub; EP 346935; EP 393855; EP 469916; EP 481788; EP
  491560; EP 500068; US 5030317
Patent Details:
                                    Filing Notes
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
EP 609860
             A2 E 12 B41J-002/16
   Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL
   PT SE
                    9 B41J-002/16
JP 6286149
             Α
                                    Cont of application US 94190464
US 5478606
             Α
                    11 B05D-003/06
EP 609860
             A3
                      B41J-002/16
CN 1104585
             Α
                      B41J-002/16
EP 609860
             B1 E
                      B41J-002/16
   Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL
   PT SE
             E
                      B41J-002/16
                                    Based on patent EP 609860
DE 69410648
             T3
                      B41J-002/16
                                    Based on patent EP 609860
ES 2116478
             B1
                      B41J-002/07
KR 152452
CN 1080645
                      B41J-002/16
```

Abstract (Basic): EP 609860 A

The mfr. comprises A) forming an ink flow path pattern on a substrate (II), having ink ejection pressure generating elements, using a dissoluble resin (III); B) forming a resin coating layer (IV) on the pattern, which serve as ink flow path walls, by dissolving a coating resin (V) which is solid at normal temps. and contains an epoxy resin (VI) in a solvent (VII) then coating the soln. on the ink flow path pattern; C) forming ink ejection outlets in (IV) above the ink ejection pressure generating elements; and D) dissolving the ink flow path pattern.

There is a further step after dissolving the ink flow path pattern of dipping (IU) in a soln. contg. a reducing agent (X) and heating. The ink ejection outlet's are formed by photolithography, by dry etching with oxygen plasma, or by an eximer laser. The conc. of the (V) in (VII) is pref. 30-70 (40-60) wt.%, it is a photosensitive resin and contains a cationic photopolymerisation initiator (VIII), pref. an aromatic iodonium salt and a reducing agent (IX), pref. Cu triflate. (VI) has an epoxy equiv. of 2,000 or less. (X) contains Cu ions, pref. Cu triflate.

USE/ADVANTAGE - (I) is effective for a full line type recording head and for a colour recording head. The distance between the ink ejection pressure generating element and the orifice is set with high precision and high reproducibility. Laser and plasma do not damage the base plate during prodn. (V) may be thermosetting or photosensitive.

Dwg.1/7

Title Terms: INK; JET; RECORD; HEAD; MANUFACTURE; FULL; LINE; TYPE; RECORD; HEAD; FORMING; INK; FLOW; PATH; PATTERN; COATING; EPOXY; RESIN; FORMING; INK; EJECT; OUTLET; COATING; DISSOLVE; PATTERN; COLOUR; RECORD; HEAD Derwent Class: A89; G06; P42; P75; P78; T04
International Patent Class (Main): B05D-003/06; B41J-002/07; B41J-002/16
International Patent Class (Additional): B41J-002/015; B44C-001/22; G01D-015/18
File Segment: CPI; EPI; EngPI

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-286149

(43)公開日 平成6年(1994)10月11日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所

B41J 2/16

9012-2C

B41J 3/04 103 H

審査請求 未請求 発明の数14 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平6-10078

(22)出願日

平成6年(1994)1月31日

(31) 優先権主張番号 特願平5-16238

(32)優先日

平5 (1993) 2月3日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 大熊 典夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 佐藤 環樹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 宮川 昌士

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)

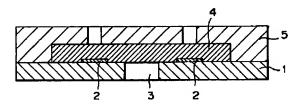
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッドの製造方法

(57) 【要約】

【目的】 インク吐出圧発生素子とオリフィス間の距離 を極めて高い精度で短くかつ再現よく設定可能で、高品 位記録が可能なインクジェット記録ヘッドの製造方法を 提供する。

【構成】 インク吐出圧力発生素子が形成された基体上 に、①溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成す る工程と、②常温にて固体状のエポキシ樹脂を含む被覆 樹脂を溶媒に溶解して、これを溶解可能な樹脂層上にソ ルベントコートすることによって、溶解可能な樹脂層上 にインク流路壁となる被覆樹脂層を形成する工程と、③ インク吐出圧力発生素子上方の被覆樹脂層にインク吐出 口を形成する工程と、④溶解可能な樹脂層を溶出する工 程と、を有することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インク吐出圧力発生素子が形成された基

①溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成する工 程と、

②常温にて固体状のエポキシ樹脂を含む被覆樹脂を溶媒 に溶解し、これを前記溶解可能な樹脂層上にソルベント コートすることによって、前記溶解可能な樹脂層上にイ ンク流路壁となる被覆樹脂層を形成する工程と、

③前記インク吐出圧力発生素子上方の前記被覆樹脂層に 10 インク吐出口を形成する工程と、

④前記溶解可能な樹脂層を溶出する工程と、を有するこ とを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項2】 前記被覆樹脂が、感光性樹脂であり、光 カチオン重合開始剤を含有することを特徴とする請求項 1 に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項3】 前記被覆樹脂が還元剤を含有することを 特徴とする請求項2に記載のインクジェット記録ヘッド の製造方法。

【請求項4】 前記光カチオン重合開始剤が芳香族ヨウ 20 ドニウム塩であることを特徴とする請求項2に記載のイ ンクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項5】 前記還元剤が銅トリフラートであること を特徴とする請求項3に記載のインクジェット記録ヘッ ドの製造方法。

【請求項6】 前記エポキシ樹脂のエポキシ当量が20 00以下であることを特徴とする請求項1に記載のイン クジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項7】 前記溶解可能な樹脂層を溶出する工程の 後に、前記被覆樹脂層を還元剤を含有する溶液に浸漬し 30 て加熱する工程を有することを特徴とする請求項1に記 載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項8】 前記還元剤が銅イオンを含有することを 特徴とする請求項7に記載のインクジェット記録ヘッド の製造方法。

【請求項9】 前配還元剤が銅トリフラートを含有する ことを特徴とする請求項7に記載のインクジェット記録 ヘッドの製造方法。

【請求項10】 前記インク吐出口がフォトリソグラフ 載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項11】 前記インク吐出口が酸素プラズマによ るドライエッチングによって形成されることを特徴とす る請求項1に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方 法。

【請求項12】 前記インク吐出口がエキシマレーザー によって形成されることを特徴とする請求項1に記載の インクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項13】 前配溶媒に溶解された被覆樹脂の濃度 $m3.0 \sim 7.0 \text{ w t}$ %であることを特徴とする請求項1に 50 ため、インク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離の

記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項14】 前配溶媒に溶解された被覆樹脂の溶液 中の濃度が40~60wt%であることを特徴とする請 求項13に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインクジェット記録方式 に用いる記録液小滴を発生するためのインクジェット記 録ヘッドの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式(液体噴射記録 方式) に適用されるインクジェット記録ヘッドは、一般 に微細な記録液吐出口(以下、オリフィスと称す)、液 流路および該液流路の一部に設けられる液体吐出エネル ギー発生部を複数備えている。そして、このようなイン クジェット記録ヘッドで高品位の画像を得るためには、 前記オリフィスから吐出される記録液小滴がそれぞれの 吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが 望ましい。これを達成するために、特開平4-1094 0号~特開平4-10942号公報においては、インク 吐出圧力発生素子(電気熱変換素子)に記録情報に対応 して駆動信号を印加し、電気熱変換素子にインクの核沸 騰を越える急激な温度上昇を与える熱エネルギーを発生 させ、インク内に気泡を形成させ、この気泡を外気と連 通させてインク液滴を吐出させる方法が開示されてい る。

【0003】このような方法を実現するためのインクジ ェット記録ヘッドとしては、電気熱変換素子とオリフィ スとの距離(以下、「OH距離」と称す。)が短い方が 好ましい。また、前記方法においては、OH距離がその 吐出体積をほぼ決定するため、OH距離を正確に、また 再現良く設定できることが必要である。

【0004】従来、インクジェット記録ヘッドの製造方 法としては、特開昭57-208255号公報~特開昭 57-208256号公報に記載されている方法、すな わち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上にイ ンク流路およびオリフィス部からなるノズルを感光性樹 脂材料を使用してパターン形成して、この上にガラス板 ィーによって形成されることを特徴とする請求項2に記 40 などの蓋を接合する方法や、特開昭61-154947号公報に記載されている方法、すなわち、溶解可能な樹 脂にてインク流路パターンを形成し、該パターンをエポ キシ樹脂などで被覆して該樹脂を硬化し、基板を切断後 に前記溶解可能な樹脂パターンを溶出除去する方法等が ある。しかし、これらの方法は、いずれも気泡の成長方 向と吐出方向とが異なる(ほぼ垂直)タイプのインクジ ェット記録ヘッドの製造方法である。そして、このタイ プのヘッドにおいては、基板を切断することによりイン ク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離が設定される

制御においては、切断精度が非常に重要なファクターと なる。しかしながら、切断はダイシングソー等の機械的 手段にて行うことが一般的であり、高い精度を実現する ことは難しい。

【0005】また、気泡の成長方向と吐出方向とがほぼ 同じタイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法とし ては、特開昭58-8658号公報に記載されている方 法、すなわち、基体とオリフィスプレートとなるドライ フィルムとをパターニングされた別のドライフィルムを 介して接合し、フォトリソグラフィーによってオリフィ スを形成する方法や、特開昭62-264975号公報 に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生 素子が形成された基体と電鋳加工により製造されるオリ フィスプレートとをパターニングされたドライフィルム を介して接合する方法等がある。しかし、これらの方法 では、いずれもオリフィスプレートを薄く(例えば20 μm以下)かつ均一に作成することは困難であり、たと え作成できたとしても、インク吐出圧力発生素子が形成 された基体との接合工程はオリフィスプレートの脆弱性 により極めて困難となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の賭点に鑑み成されたものであって、インク吐出圧力発生素子とオリフィス間の距離を極めて高い精度で短くかつ再現よく設定可能で、高品位記録が可能なインクジェット記録へッドの製造方法を提供することを目的とする。

【0007】さらに本発明の別な目的は、製造工程を短縮化することができ、安価で信頼性の高いインクジェット記録へッドを得ることのできるインクジェット記録へッドの製造方法を提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明の形態は、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上に、①溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成する工程と、②常温にて固体状のエポキシ樹脂を含む被覆樹脂を溶媒に溶解して、これを前記溶解可能な樹脂層上にソルペントコートすることによって、前記溶解可能な樹脂層上にインク流路壁となる被覆樹脂層を形成する工程と、③前記インク吐出圧力発生素子上方の前記被覆樹脂層にインク吐出口を形成する工程と、④前記溶解可40能な樹脂層を溶出する工程と、を有することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法である。

[0009]

【作用】本発明によれば、インク吐出圧力発生素子とオリフィス間の距離を極めて高い精度で短くかつ再現よく設定可能で、高品位記録が可能なインクジェット記録へッドの製造方法を提供することができるものである。

[0010]

【実施例】以下、図面を参照しつつ本発明を詳細に説明 する。 【0011】図1から図6は、本発明の基本的な態様を示すための摸式図であり、図1から図6のそれぞれには、本発明の方法に係わるインクジェット記録ヘッドの構成とその製作手順の一例が示されている。

【0012】まず、本態様においては、例えば図1に示されるような、ガラス、セラミックス、プラスチックあるいは金属等からなる基板1が用いられる。

【0013】このような基板1は、液流路構成部材の一部として機能し、また、後述のインク流路およびインク10 吐出口を形成する材料層の支持体として機能し得るものであれば、その形状、材質等に特に限定されることなく使用できる。上記基板1上には、電気熱変換素子あるいは圧電素子等のインク吐出エネルギー発生素子2が所望の個数配置される。このような、インク吐出エネルギー発生素子2によって記録液小滴を吐出させるための吐出エネルギーがインク液に与えられ、記録が行われる。ちなみに、例えば、上記インク吐出エネルギー発生素子2として電気熱変換素子が用いられる時には、この素子が近傍の記録液を加熱することにより、記録液に状態変化20 を生起させ吐出エネルギーを発生する。また、例えば、圧電素子が用いられる時は、この素子の機械的振動によって、吐出エネルギーが発生される。

【0014】なお、これらの素子2には、これら素子を動作させるための制御信号入力用電極(図示せず)が接続されている。また、一般にはこれら吐出エネルギー発生素子の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられるが、もちろん本発明においてもこのような機能層を設けることは一向に差し支えない。

【0015】図1において、インク供給のための開口部3を基板1上に予め設けておき、基板後方よりインクを供給する形態を例示した。該開口部3の形成においては、基板1に穴を形成できる手段であれば、いずれの方法も使用できる。例えば、ドリル等機械的手段にて形成しても構わないし、レーザー等の光エネルギーを使用しても構わない。また、基板1にレジストパターン等を形成して化学的にエッチングしても構わない。

【0016】もちろん、インク供給口を基板1に形成せず、樹脂パターンに形成し、基板1に対してインク吐出口と同じ面に設けてもよい。

【0017】次いで、図2(図1のA-A′断面図)に示すように、上記インク吐出エネルギー発生素子2を含む基板1上に、溶解可能な樹脂にてインク流路パターン4を形成する。最も一般的な手段としては感光性材料にて形成する手段が挙げられるが、スクリーン印刷法等の手段にても形成は可能である。感光性材料を使用する場合においては、インク流路パターンが溶解可能であるため、ポジ型レジストか、あるいは溶解性変化型のネガ型レジストの使用が可能である。

【0018】レジスト層の形成の方法としては、基板上 50 にインク供給口を設けた基板を使用する場合には、該感

光性材料を適当な溶剤に溶解し、PETなどのフィルム上に蟄布、乾燥してドライフィルムを作成し、ラミネートによって形成することが好ましい。上述のドライフィルムとしては、ポリメチルイソプロピルケトン、ポリピニルケトン等のピニルケトン系光崩壊性高分子化合物を好適に用いることができる。というのは、これら化合物は、光照射前は高分子化合物としての特性(被膜性)を維持しており、インク供給口3上にも容易にラミネート可能であるためである。

【0019】また、インク供給口3に後工程で除去可能 10 な充填物を配置し通常のスピンコート法、ロールコート法等で被膜を形成しても構わない。

【0020】このように、インク流路をパターニングした溶解可能な樹脂材料層4上に、図3に示すように、さらに被覆樹脂層5を通常のスピンコート法、ロールコート法等で形成する。ここで、該樹脂層5を形成する工程において、溶解可能な樹脂パターンを変形せしめない等の特性が必要となる。すなわち、被覆樹脂層5を溶剤に溶解し、これをスピンコート、ロールコート等で溶解可能な樹脂パターン4上に形成する場合、溶解可能な樹脂 20パターン4を溶解しないように溶剤を選択する必要がある。

【0021】次に、本発明に用いる被覆樹脂層5について説明する。被覆樹脂層5としては、インク吐出口3をフォトリソグラフィーで容易にかつ精度よく形成できることから、感光性のものが好ましい。このような感光性被覆樹脂層5は、構造材料としての高い機械的強度、基板1との密着性、耐インク性と、同時にインク吐出口の微細なパターンをパターニングするための解像性が要求される。ここで、本件発明者は、鋭意検討の結果、エボ 30 キシ樹脂のカチオン重合硬化物が構造材料として優れた強度、密着性、対インク性を有し、かつ前記エポキシ樹脂が常温にて固体状であれば、優れたパターニング特性を有することを見いだし、本発明に至った。

【0022】まず、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較して高い架橋密度(高Tg)を有するため、構造材として優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエポキシ樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中への拡散が抑40えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることができる

【0023】溶解可能な樹脂層上に被覆樹脂層を形成する工程は、常温で固体状の被覆樹脂を溶剤に溶解し、スピンコート法で形成することが望ましい。

【0024】 薄膜コーティング技術であるスピンコート 法を用いることで、被覆樹脂層 5 は均一にかつ精度良く 形成することができ、従来方法では困難であったインク 吐出圧力発生素子2とオリフィス間の距離を短くするこ とができ、小液滴吐出を容易に達成することができる。 【0025】ここで、被覆樹脂層5は溶解可能な樹脂層4上にフラットに形成されることが望ましい。これは下記の理由による。

【0026】・オリフィス面に凸凹があると凹部に不要なインク溜を生じること、

・被覆樹脂層 5 にインク吐出口を形成する際に加工が容易であること。

【0027】そこで、本発明者らは、被覆樹脂層5をフラットに形成する条件を鋭意検討したところ、被覆樹脂の溶剤に対する濃度が被覆樹脂層5の平滑性の点で非常に重大なファクターとなっていることを見いだした。具体的にはスピンコート時に被覆樹脂を溶剤に対して30~70 w t %の濃度で、さらに好ましくは40~60 w t %の濃度で溶解させることにより被覆樹脂層5表面をフラットにすることが可能となる。

【0028】ここで、被覆樹脂を30wt%未満の濃度で溶解し、スピンコートを行った時には、形成された被覆樹脂層がパターニングされた溶解可能な樹脂層4にならって凸凹を生じてしまう。また、被覆樹脂を70wt%を越える濃度で溶解した場合には、溶液自体が高粘度になり、スピンコート不能となるか、例え、スピンコートできたとしても、その膜厚分布が悪化する。

【0029】そもそもスピンコート法により塗布を行う場合は、塗布剤の粘度を10~3000cpsとする必要がある。これは粘度が低過ぎる時には塗布剤が流れ出してしまい、粘度が高すぎる場合は塗布剤が均等にゆきわたってくれないからである。したがって、被覆樹脂含有溶液の粘度が上述の濃度において所望の粘度となるように溶剤を適宜選択することが必要である。

【0030】また、被覆樹脂5として上述のいわゆるネガ型の感光性材料を用いた場合、通常は基板面からの反射、およびスカム(現像残渣)が発生する。しかしながら、本発明の場合、溶解可能な樹脂にて形成されたインク流路上に吐出口パターンを形成するため、基板からの反射の影響は無視でき、さらに現像時に発生するスカムは、後述のインク流路を形成する溶解可能な樹脂を洗い出す工程でリフトオフされるため、悪影響を及ぼさない。

【0031】本発明に用いる固体状のエポキシ樹脂としては、ピスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物のうち分子量がおよそ900以上のもの、含プロモスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物、フェノールノボラックあるいはo-クレゾールノボラックとエピクロヒドリンとの反応物、特開昭60-161973号公報、特開昭63-221121号公報、特開昭64-9216号公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシクロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂等があげられるが、もちろん本発明はこれら化合物に限定されるわけではない。

50 【0032】また、上述のエポキシ化合物においては、

好ましくはエポキシ当量が2000以下、さらに好まし くはエポキシ当量が1000以下の化合物が好適に用い られる。これは、エポキシ当量が2000を越えると、 硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のTgもしく は熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題 が生じる場合があるからである。

【0033】上記エポキシ樹脂を硬化させるための光力 チオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩、芳 香族スルホニウム塩 [J. POLYMER SCI:S ymposium No. 56 383-395 (197 6) 参照] や旭電化工業株式会社より上市されているS P-150、SP-170等が挙げられる。

【0034】また、上述の光カチオン重合開始剤は、還 元剤を併用し加熱することによって、カチオン重合を促 進(単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上す る。) させることができる。ただし、光カチオン重合開 始剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せず一定温 度以上 (好ましくは60℃以上) で反応するいわゆるレ ドックス型の開始剤系になるように、還元剤を選択する 必要がある。このような還元剤としては、銅化合物、特 20 に反応性とエポキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフ ラート(トリフルオロメタンスルフォン酸銅(II))が 最適である。また、アスコルビン酸等の還元剤も有用で ある。また、ノズル数の増加(高速印刷性)、非中性イ ンクの使用(着色剤の耐水性の改良)等、より高い架橋 密度(高Tg)が必要な場合は、上述の還元剤を後述の ように前記被覆樹脂層の現像工程後に溶液の形で用いて 被覆樹脂層を浸漬および加熱する後工程によって、架橋 密度をあげることができる。

【0035】さらに上記組成物に対して必要に応じて添 30 加剤など適宜添加することが可能である。例えば、エポ キシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加し たり、あるいは基板との更なる密着力を得るためにシラ ンカップリング剤を添加することなどがあげられる。

【0036】次いで、上記化合物からなる感光性被覆樹 胎層5に対して、図4に示すように、マスク6を介して パターン露光を行う。本態様の感光性被覆樹脂層5は、 ネガ型であり、インク吐出口を形成する部分をマスクで 遊蔽する(むろん、電気的な接続を行う部分も遮蔽す る。図示せず。)。

【0037】パターン露光は、使用する光カチオン重合 開始剤の感光領域に合わせて紫外線、Deep-UV 光、電子線、X線などから適宜選択することができる。

【0038】ここで、これまでの工程は、すべて従来の フォトリソグラフィー技術を用いて位置合わせが可能で あり、オリフィスプレートを別途作成し基板と張り合せ る方法に比べて、格段に精度をあげることができる。こ うしてパターン露光された感光性被覆樹脂層5は、必要 に応じて反応を促進するために、加熱処理を行ってもよ 固体状のエポキシ樹脂で構成されているため、パターン 露光で生じるカチオン重合開始種の拡散は制約を受け、 優れたパターニング精度、形状を実現できる。

【0039】次いで、パターン露光された感光性被覆樹 脂層 5 は、適当な溶剤を用いて現像され、図 5 に示すよ うに、インク吐出口を形成する。ここで、未露光の感光 性被覆樹脂層の現像時に同時にインク流路を形成する溶 解可能な樹脂パターン4を現像することも可能である。 ただし、一般的に、基板1上には複数の同一または異な る形態のヘッドが配置され、切断工程を経てインクジェ ット記録ヘッドとして使用されるため、切断時のごみ対 策として、図5に示すように感光性被覆樹脂層5のみを 選択的に現像することにより、インク流路を形成する樹 脂パターン4を残し(液室内に樹脂パターン4が残存す るため切断時に発生するゴミが入り込まない)、切断工 程後に樹脂パターン4を現像することも可能である(図 6)。また、この際、感光性被覆樹脂層5を現像する時 に発生するスカム (現像残渣) は、溶解可能な樹脂層 4 と共に溶出されるためノズル内には残渣が残らない。

【0040】前述したように架橋密度を上げる必要があ る場合には、この後、インク流路およびインク吐出口が 形成された感光性被覆樹脂層5を還元剤を含有する溶液 に浸漬および加熱することにより後硬化を行う。これに より、感光性被覆樹脂層5の架橋密度はさらに高まり、 基板に対する密着性および耐インク性は非常に良好とな る。もちろん、この銅イオン含有溶液に浸漬加熱する工 程は、感光性被覆樹脂層5をパターン露光し、現像して インク吐出口を形成した直後に行っても一向にさしつか えなく、その後で溶解可能な樹脂パターン4を溶出して も構わない。また浸漬、加熱工程は、浸漬しつつ加熱し ても構わないし、浸漬後に加熱処理を行っても構わな .43

【0041】このような還元剤としては、還元作用を有 する物質であれば有用であるが、特に銅トリフラート、 酢酸銅、安息香酸銅など銅イオンを含有する化合物が有 効である。前記化合物の中でも、特に銅トリフラートは 非常に高い効果を示す。さらに前記以外にアスコルピン 酸も有用である。

【0042】このようにして形成したインク流路および 40 インク吐出口を形成した基板に対して、インク供給のた めの部材7およびインク吐出圧力発生素子を駆動するた めの電気的接合(図示せず)を行ってインクジェット記 録ヘッドが形成される(図7)。

【0043】本実施態様では、インク吐出口の形成をフ ォトリソグラフィーによって行ったが、本発明はこれに 限ることなく、マスクを変えることによって、酸素プラ ズマによるドライエッチングやエキシマレーザーによっ てもインク吐出口を形成することができる。エキシマレ ーザーやドライエッチングによってインク吐出口を形成 い。ここで、前述のごとく、感光性被覆樹脂層は常温で 50 する場合には、基板が樹脂パターンで保護されてレーザ

-419-

ーやプラズマによって傷つくことがないため、精度と信 頼性の高いヘッドを提供することも可能となる。さら に、ドライエッチングやエキシマレーザー等でインク吐 出口を形成する場合は、被覆樹脂層 5 は感光性のもの以 外にも熱硬化性のものも適用可能である。

【0044】本発明は、記録紙の全幅にわたり同時に記 録ができるフルラインタイプの記録ヘッドとして、さら には記録ヘッドを一体的にあるいは複数個組み合わせた カラー記録ヘッドにも有効である。

【0045】また、本発明による記録ヘッドは、ある温 10 度以上で液化する固体インクにも好適に適用される。

【0046】 (実施例)以下、本発明の実施例を示す。

【0047】・実施例1

本実施例では、前述の図1~図7に示す手順にしたがっ て、インクジェット記録ヘッドを作製した。

[0048]まず、吐出エネルギー発生素子としての電 気熱変換素子 2 (材質HfB2 からなるヒーター)を形 成したシリコン基板1上にプラストマスクを設置し、サ ンドプラスト加工によりインク供給のための貫通口3を 形成した(図1)。

【0049】次いで、該基板1上に、溶解可能な樹脂層 4としてポリメチルイソプロペニルケトン(東京応化工 業 (株) 社製ODUR-1010) をPET上に塗布、 乾燥しドライフィルムとしたものをラミネートにより転 写した。なお、ODUR-1010は、低粘度であり厚 膜形成できないため濃縮して用いた。

【0050】次いで、120℃にて20分間プリベーク した後、キヤノン製マスクアライナーPLA520(コ ールドミラーCM290) にてインク流路のパターン露 光を行った。露光は1.5分間、現像はメチルイソプチ 30 ルケトン/キシレン=2/1、リンスはキシレンを用い た。該溶解可能な樹脂で形成されたパターン4は、イン ク供給口3と電気熱変換素子2とのインク流路を確保す るためのものである(図2)。なお、現像後のレジスト の膜厚は10μmであった。

【0051】次いで、表1に示す樹脂組成物をメチルイ ソプチルケトン/キシレン混合溶媒に50wt%の濃度 で溶解し、スピンコートにて感光性被覆樹脂層5を形成 した。 (パターン4上における膜厚10μm 図3)。

[0052] 次いで、PLA520 (CM250) に て、インク吐出口形成のためのパターン露光を行った (図4)。なお、露光は10秒、アフターペークは60 ℃ 30分間行った。

【0053】次いで、メチルイソプチルケトンで現像を 行い、インク吐出口を形成した。なお、本実施例ではゆ 25μmの吐出口パターンを形成した。

【0054】また、前記条件ではインク流路パターン4 は完全に現像されず残存している。

【0055】通常、基板1上には複数の同一または異な る形状のヘッドが配置されているために、この段階でダ 50 後に、再び印字を行ったところ、保存試験前と同様な印

イサー等により切断し、個々のインクジェット記録へッ ドを得るが、ここでは前述の通りにインク流路パターン 4が残存しているため、切断時に発生するゴミがヘッド 内に侵入することを防止できる。こうして得られたイン クジェット記録ヘッドは、再びPLA520(CM29 0) にて2分間露光し、メチルイソプチルケトン中に超 音波を付与しつつ浸漬し、残存しているインク流路パタ ーン4を溶出した(図6)。

10

【0056】次いで、インクジェット記録ヘッドを、1 50℃ 1時間加熱し感光性被覆材料層5を完全に硬化

【0057】最後に、図7に示すように、インク供給口 にインク供給部材?を接着してインクジェット記録へッ ドが完成する。

【0058】このようにして作成したインクジェット記 録ヘッドを記録装置に装着し、純粋/ジエチレングリコ ール/イソプロピルアルコール/酢酸リチウム/黒色染 料フードプラック 2 = 79. 4/15/3/0. 1/ 2. 5からなるインクを用いて記録を行なったところ、 20 安定な印字が可能であり、得られた印字物は高品位なも のであった。

【0059】・実施例2

ついで、前記実施例1の感光性被覆樹脂層5を表2に示 す組成に変えて、同様に評価を行なった。本実施例は、 光カチオン重合開始剤と還元剤を併用することでノズル 構成材料(感光性被覆樹脂の硬化物)の機械的強度、基 板1に対する密着性等をより向上させたものである。感 光性被覆樹脂層5の形成までは、実施例1と同様に行な った。インク吐出口のパターン露光は、PLA520 (CM250) で5秒間、アフターペークは60℃ 1 0分間行なった。この条件では、光カチオン重合開始剤 と還元剤 (銅トリフラート) は実質的に反応しないた め、光によるパターニングが可能である。

【0060】ついで、実施例1と同様に現像、切断、イ ンク流路4の洗い出しを行なった後に、150℃で1時 間ベーク処理を行なった。この段階で光カチオン重合開 始剤と銅トリフラートが反応し、エポキシ樹脂のカチオ ン重合を促進する。こうして得られたエポキシ樹脂の硬 化物は、光のみで硬化させたものに比べて架橋密度が高 40 く、機械的強度、基板との密着性、耐インク性に優れる ものであった。また、このようにして作成したインクジ ェット記録ヘッドを記録装置に装着し、実施例1と同様 に、純粋/ジエチレングリコール/イソプロピルアルコ ール/酢酸リチウム/黒色染料フードブラック2=7 9. 4/15/3/0. 1/2. 5からなるインクを用 いて記録を行なったところ、安定な印字が可能であり、 得られた印字物は高品位なものであった。

【0061】さらに、このインクジェット記録ヘッドに 前記インクを充填した状態で、60℃ 3か月保存した

字物を得ることができた。

【0062】· 実施例3

次いで、前記実施例1のインクジェット記録ヘッドを還 元剤を含有する溶液に浸漬、加熱する後工程を行い、同 様に評価を行った。

【0063】 実施例1のインク流路4の洗い出し工程の 後に、銅トリフラートの2wt %エタノール溶液に30 分間超音波を付与しつつ浸漬し、乾燥後、150℃で2 時間加熱処理を行い、加熱処理後に純水洗浄を行った。 材7を接着して、インクジェット記録ヘッドが完成す る。

【0064】このようにして作成したインクジェット記 録ヘッドを記録装置に装着し、実施例1と同様に、純粋 /ジエチレングリコール/イソプロピルアルコール/酢 酸リチウム/黒色染料フードプラック2=79.4/1 5/3/0.1/2.5からなるインクを用いて記録を* *行なったところ、安定な印字が可能であり、得られた印 字物は高品位なものであった。

12

【0065】ここで、銅イオン浸漬による架橋密度の向 上を確認するために、以下の実験を行った。表1に示す 組成物をカプトンフィルム上に10 µm厚で形成し、光 硬化させた後に、銅イオンを含有するエタノール溶液に 浸渍、加熱処理を行ったサンプル(a)と、銅イオンを 含まない純粋なエタノール溶液に浸漬、加熱処理を行っ たサンプル (b) を作製した。これらサンプルのガラス 次いで、実施例1と同様にインク供給口にインク供給部 10 転移点(Tg)を動的粘弾性評価を用いて測定したとこ ろ、サンプル (a) はTg=240℃、(b) はTg= 200℃であった。上記結果より明らかなように、銅イ オンによる後処理で架橋密度の向上がなされ、信頼性の 高いインクジェット記録ヘッドを作製することができ る。

[0066]

【表1】

エポキシ 樹脂	o-クレソールノホラック型エポキシ樹脂 (油化シェル社製エヒコート180H65)	100 部
光カチオン 軍合開始剤	4.4'-ジーセーブチルフェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート	1部
シランカップ リング剤	日本ユニカー社製 A-187	10部

[0067]

※ ※【表2】

エポキシ 樹脂	オキシシクロヘキサン骨格の多官能エポキシ樹脂(ダイセル化学社製EHPE-3150)	100部
光カチオン 重合開始剤	4.4`-ジーセーブチルフェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート	0.5部
還元剤	銅トリフラート	0.5部
シランカップ リング剤	日本ユニカー社製 A-187	5部

[0068]

【発明の効果】以上説明した本発明によってもたらされ る効果としては、インク吐出圧力発生素子とオリフィス 間の距離、位置精度を厳密に制御できるため、吐出特性 の安定しかつ信頼性の高いインクジェット記録ヘッドが 簡単な手法にて製造できることが挙げられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】インク流路、オリフィス部形成前の基板の模式 的斜視図である。

【図2】溶解可能なインク流路パターンを形成した基板 の模式図である。

【図3】被覆樹脂層を形成した基板の模式図である。

50

1

【図4】 被覆樹脂層にインク吐出口のパターン露光を行っている基板の模式図である。

【図5】パターニングされた被覆樹脂層を現像した基板の模式図である。

【図6】溶解可能な樹脂パターンを溶出した基板の模式 図である。

【図7】インク供給部材を配置した基板の模式図である。

【符号の説明】

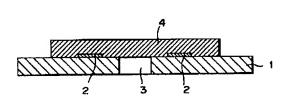
- 1 基板
- 2 インク吐出圧力発生素子
- 3 インク供給口
- 4 溶解可能な樹脂層で形成されたインク流路

14

- 5 被覆樹脂層
- 6 マスク
- 7 インク供給部材

3 2 2 2 2 2 3 1

[図1]

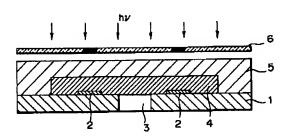


【図2】

【図3】

5 2 3 2 (図 5)

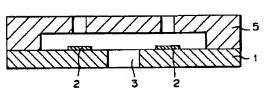
【図4】

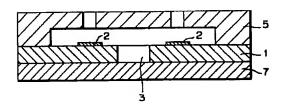


2 3 2

[図7]

【図6】





フロントページの続き

(72)発明者 稲田 源次

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 戸島 博彰

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内